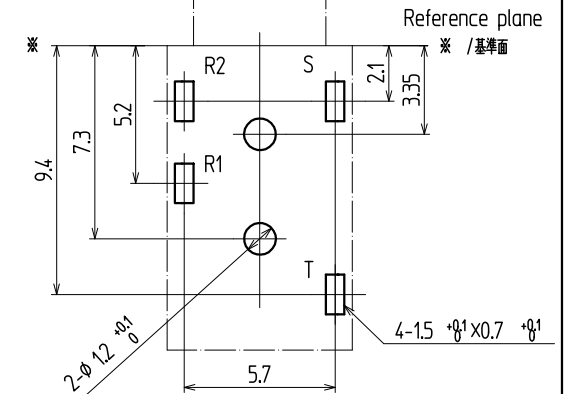
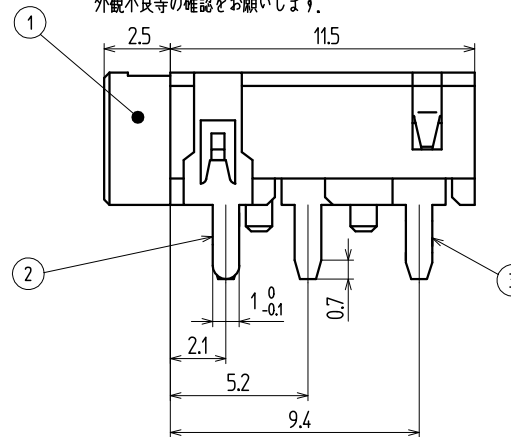


Circuit / 回路図

Note

注記

1. Take care not to let the solder flow into the part of A when you solder a jack with a soldering iron.
半田コテにて半田付けする場合は、A部に半田が流れ込まない様に注意して下さい。
2. Use a jig tool to fix the jack to a PCB so that it would not suspend from the PCB when you dip the jack into a soldering bath.
半田槽にてディップする場合は、治具等を用いてジャックの浮きが生じない様にして下さい。
3. In case use P.C board of through holes, don't prepare a land in part side.
スルーホール基板を使用する際は、部品面側にランドを設けない事。
4. When soldering in auto soldering bath, it is suggested to check contact failure, appearance failuer etc, by flux before.
自動半田槽にて半田付けを行う際には、事前にフラックス流入による接触不良、外観不良等の確認をお願いします。



Note / 注3

t1.2 Referential dimensions of PC board holes / t1.2 参考基板孔寸法図
(Dip-side view/ディップ側)(Tolerance/公差 ALL±0.1)(S=2/1)

TOLERANCE 寸法公差			X		
6	under 未満	± 0.3	X		
over 以上	6	under 未満	20	± 0.4	X
over 以上	20	under 未満		± 0.5	X
over 以上				±	X
ANGLE(DEG) 角度		± 0°	MARK 記号		

REVISIONS 改訂事項		DATE 日付	SIGN 担当

No. 品番	PARTS NAME 名称	QTY 個数	MATERIAL 材質	No.	UL	FINISH 処理	REMARKS 備考
3	CONTACT コンタクト	3	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	10.25	(T,R1,R2)		SILVER PLATED Agめっき
2	EARTH CONTACT アースパネ	1	PHOSPHOR BRONZE りん青銅	10.25	(S)		SILVER PLATED Agめっき
1	HOUSING ハウジング	1	PA66 G15% 黒			94V-0	

APPROVED 責任者		CHECKED 検査者		DRAWN 製図者		DESIGNED 設計者	

ALL DIMENSIONS IN () ARE FOR REFERENCES ONLY ()印は、参考寸法		TITLE 名称		ISSUED 出図	
		3.5 DIA PHONE JACK / 小形車頭ジャック			
		CODE No. コードNo.			
		YKB21-5347			
		UNIT 単位			
		mm			
		SCALE 尺度			
		5/1			

TOHOKU TATSUMI CO.,LTD.